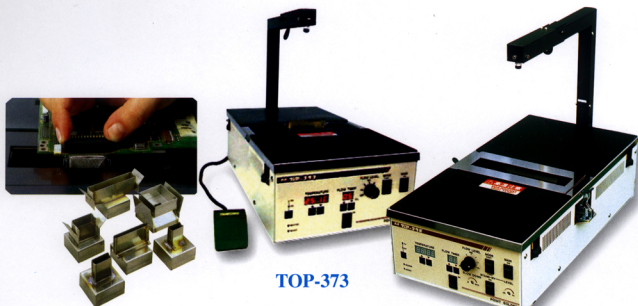


DIP IC 납땜 및 땀납 제거장비 Bench top Wave Soldering Machine

DIP IC나 Thru-Hole 부품의 소량납땜이나 부분수리와 컴퓨터 마더보드의 커넥터, PGA 소켓, 반도체 Burn-in-Board 소켓 수리에 적합하며 Point Solder 방식을 Wave Solder 방식.



TOP-373

TOP-375

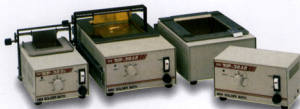
제품 특징

- 부품별 다양한 Nozzle 구비 및 교환용이.
- Laser Point를 이용하여 위치 선정 정확.
- 평면 Table 방식으로 최대 600 x 600 mm까지 사용가능.
- 작업 Table의 상·하 높이 조절가능.
- 450W의 Heater 2개를 사용하여 열용량의 안전성 확보.
- 센서 Feedback CPU방식으로 온도편차 $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- 정전기방지용 Workmat 부착.
- Stand-by 기능으로 작업성이 뛰어나.
- 무연납 사용가능.

Specifications

	TOP-373	TOP-375	TOP-375SP
전 원	AC 100 / 230 V (50 / 60 HZ) 선택		
소비전력	950 W		
온도설정	200~350℃ (±1℃)		
온도방식	Sensor Feed Back CPU		
히터용량	900 W	920 W	
납납용량	약 15 Kg		
최대 보드크기	600 x 600 mm		
제품크기	280W x 558D x 180H		280W x 400D x 156H
제품중량	약 18 Kg		약 15 Kg
Stand-by기능	불가능	가능	

TOP-303B



- Socket이나 Wire등의 작업을 최소의 비용으로 가능.
- Techno Design에서 독자 개발한 온도조절 회로 채용.
- 산화막 제거 기능.

Specifications

	TOP-304AH	TOP-304A	TOP-303B
전 원	AC 100 V 50-60 Hz		
히터전력	600 W	600 W	300 W
온도방식	Sensor Feed Back Zero Cross System (독자기발)		
온도설정	200 $^{\circ}\text{C}$ ~ 450 $^{\circ}\text{C}$	200 $^{\circ}\text{C}$ ~ 350 $^{\circ}\text{C}$	200 $^{\circ}\text{C}$ ~ 450 $^{\circ}\text{C}$
유효면적	100(W) x 140(D) x 50(H) mm		60(W) x 60(D) x 46(H) mm
납 용 량	약 6.4 Kg	약 6.4 Kg	약 1.5 Kg
크 기 (W x D x H)	납 조 167 x 223 x 101mm 콘트를 167 x 98 x 90mm	167 x 302 x 101mm	120 x 207 x 91mm
용해시간	약 10~15분		
부 속 품	납땀까지 제거용 판		